

罗博特科智能科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●被担保人：苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称“捷运昇”）、罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“南通罗博”）、捷策节能科技（苏州）有限公司（以下简称“捷策节能”）、苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）、罗博特科半导体科技（南通）有限公司（以下简称“南通半导体”）。

●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 9 亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保；截至本公告日，公司累计对外担保金额为 12,477.88 万元，无对外逾期担保。

●本次担保有无反担保：无。

●本次担保尚需提交公司股东会审议通过。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况

根据公司经营发展需要，公司及所属子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微、南通半导体预计 2025 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 45 亿元（含本数），同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、南

通罗博、捷策节能、斐控晶微、南通半导体的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 9 亿元（含本数）。该事项尚需提交公司股东会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，授信额度及担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环使用。公司对全资子公司的担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	捷运昇	100%	7.19%	-	3,000.00	3.05%	否
	南通罗博	100%	35.63%	12,477.88	60,000.00	61.08%	否
	捷策节能	100%	61.23%	-	1,000.00	1.02%	否
	斐控晶微	100%	0.04%	-	6,000.00	6.11%	否
	南通半导体	100%	15.09%	-	20,000.00	20.36%	否
合计		-	-	-	90,000.00	91.62%	-

注：上表最近一期资产负债率是指 2024 年 9 月 30 日，相关数据未经审计；最近一期净资产是指 2023 年度经审计归母净资产。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、票据池业务、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。各家银行具体授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。

二、被担保人基本情况

（一）捷运昇基本情况

- 1、被担保人名称：苏州捷运昇能源科技有限公司
- 2、成立日期：2016 年 4 月 15 日
- 3、注册地址：苏州工业园区港浪路 3 号 A 幢 401 室

4、法定代表人：李伟彬

5、注册资本：500 万人民币

6、经营范围：研发、销售：新能源设备、电子设备、实验室仪器，从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：捷运昇为公司的全资子公司，公司持有捷运昇 100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

项目/期间	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)
总资产 (万元)	6,498.30	6,122.61
总负债 (万元)	829.72	440.19
净资产 (万元)	5,668.58	5,682.42
营业收入 (万元)	2,740.53	805.87
利润总额 (万元)	782.57	21.43
净利润 (万元)	580.93	13.85

9、经核查，被担保人不是失信被执行人。

（二）南通罗博基本情况

1、被担保人名称：罗博特科智能科技南通有限公司

2、成立日期：2017 年 4 月 6 日

3、注册地址：南通市经济技术开发区驰程路 66 号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：38,000 万人民币

6、经营范围：研发、组装生产、销售新能源设备、LED 及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：南通罗博为公司的全资子公司，公司持有南通罗博 100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

项目/期间	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9 月(未经审计)
总资产(万元)	64,080.88	54,353.98
总负债(万元)	30,722.40	19,367.13
净资产(万元)	33,358.48	34,986.85
营业收入(万元)	23,032.36	26,390.53
利润总额(万元)	143.28	1,628.37
净利润(万元)	143.28	1,628.37

9、经核查，被担保人不是失信被执行人。

(三) 捷策节能基本情况

1、被担保人名称：捷策节能科技（苏州）有限公司

2、成立日期：2010年8月20日

3、注册地址：苏州工业园区港浪路3号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：1,536.3425万人民币

6、经营范围：光伏及LED设备研究与开发；智能装备制造；自有厂房租赁。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、被担保人与公司的关系：捷策节能为公司的全资子公司，公司持有捷策节能100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

项目/期间	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9 月(未经审计)
总资产(万元)	5,038.90	5,158.90
总负债(万元)	3,107.57	3,158.63
净资产(万元)	1,931.33	2,000.28
营业收入(万元)	1,738.87	1,219.82
利润总额(万元)	109.72	91.87
净利润(万元)	82.29	68.94

9、经核查，被担保人不是失信被执行人。

(四) 斐控晶微基本情况

1、被担保人名称：苏州斐控晶微技术有限公司

2、成立日期：2019年8月9日

3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区港浪路3号

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：19,000万人民币

6、经营范围：半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：斐控晶微为公司的全资子公司，公司持有斐控晶微100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

项目/期间	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)
总资产(万元)	19,933.16	19,346.44
总负债(万元)	8.23	8.43
净资产(万元)	19,924.93	19,338.01
营业收入(万元)	-	-
利润总额(万元)	76.44	-526.92
净利润(万元)	76.44	-526.92

9、经核查，被担保人不是失信被执行人。

（五）南通半导体基本情况

1、被担保人名称：罗博特科半导体科技（南通）有限公司

2、成立日期：2023年5月30日

3、注册地址：江苏省南通市开发区驰程路66号4#厂房

4、法定代表人：戴军

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、被担保人与公司的关系：南通半导体为公司的全资子公司，公司持有南

通半导体 100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

项目/期间	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)
总资产(万元)	-	1,602.31
总负债(万元)	-	241.75
净资产(万元)	-	1,360.56
营业收入(万元)	-	-
利润总额(万元)	-	-3.62
净利润(万元)	-	-3.62

9、经核查，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司在全资子公司提供担保额度的总体安排，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟向全资子公司提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控晶微、南通半导体和银行实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

2025年1月15日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外担保总额为102,477.88万元（含本次担保，本次担保需股东会审议通过后才能生效），占最近一期经审计净资产的104.32%，全部系公司对全资子公司的担保额度，均为公司对全资子公司的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保实际发生额为12,477.88万元人民币，占最近一期经审计净资产的12.70%，均为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担

保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日